



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
SEZIONE DI PERUGIA
Servizio di Direzione

Prova scritta del 18/10/2017 – Selezione PG/C6/712

Testo N. 1

Il candidato svolga il seguente tema:

Si descriva brevemente una procedura di assemblaggio di un rivelatore a microstrip per un rivelatore di particelle.

Il candidato traduca in italiano la seguente frase:

“ Wire bonding is an electrical interconnect technology developed by microelectronics industry and today used excessively in (solid state) detector construction. It allows to interconnect electronic chips, printed circuit boards, pitch adapters and solid state sensors”

MM LITE
JB

